

2005年7月5日

CMPスラリー研究開発用 300mm ウエハー対応評価設備を導入

日立化成工業株式会社(本社：東京、執行役社長：長瀬寧次、資本金：153億円)は、2005年12月完成を目標に、半導体用CMPスラリーの研究開発を促進するためのクリーンルームを山崎事業所(茨城県日立市)内に増設し、300mmウエハー対応研磨装置をはじめとする評価設備を導入します。投資額は約8億円の予定です。

CMP(化学的機械研磨：Chemical Mechanical Planarization)とは、半導体の素子分離工程や回路形成工程で発生するウエハー上の不要な材料の凹凸(シリコン酸化物被膜、層間絶縁材被膜、配線用金属被膜等)を研磨し平坦化する技術のことです。近年当社はこの用途に使用される研磨液であるCMPスラリーのシェアを高めてきており、現在のシェアは約15%(世界第2位)、特に最先端のセリア系のSTI用スラリーでは約60%、銅配線用スラリーでは約30%のシェアを有しています。

300mmウエハーは、現在普及している200mmウエハーに比べ、ウエハー1枚当たりから取れるチップ数が約2.25倍に増大するため、生産性向上とコスト削減に大幅に寄与することから、近年、半導体メーカーの間で急速に採用が進んでいます。

当社は、CMPスラリーの事業を開始して以来、お客さまと同じ環境でCMPプロセスを実現できるよう積極的に評価設備を導入し、当社製品の優位性を高めてまいりました。300mmウエハー対応については、2003年4月に経済産業省支援の下に発足したCASMAT(次世代半導体材料技術研究組合)が所有する設備や評価技術を有効活用することにより、300mmウエハー対応CMPスラリーの開発と売上拡大を進めてまいりました。

今後300mmウエハー製造ラインが本格的に立ち上がる時期を迎え、引き続きCMPスラリーにかかわる技術サービスのさらなる充実を図るため、今般、300mmウエハー対応研磨装置をはじめとする新規な評価設備を導入することに致しました。これにより、お客さまから要求されたデータの提示やお客さま立会いの下でデモ実験を行うなど、お客さまからの多様な要求に対し迅速かつ幅広い対応が可能になり、実験・評価効率が向上します。

当社では、継続的な増収増益を達成するため、経営資源を集中的に投入して拡大を図る「戦略拡大10製品」を定めており、CMPスラリーはその一つです。今般300mmウエハー対応研磨装置をはじめとするCMP評価設備を導入することにより、デザインルール65nmノード以降のプロセスに対応したCMPスラリーの開発をスピードアップさせ、一層の販売強化に努め、2007年度に約100億円の売上高達成を目指してまいります。

以上

(報道関係お問い合わせ)

日立化成工業株式会社 コーポレート戦略室 広報担当 野口 TEL 03-5381-2377